© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎國際 (TPEx: 5289) 海外法說會

董事長 簡川勝 2026.11.12-13

innodisk

免責說明

本簡報及同時發佈之財務業務訊息及預測性資訊，乃是建立在本公司從內部及外部來源所取得之資訊基礎。本公司未來實際所發生之營運結果及財務狀況可能與這些明示或暗示之預測性資訊有所差異，其原因可能來自於本公司無法掌握之各種風險因素。

本簡報中對未來的展望反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任何變動或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

議程

- 公司簡介與概況
- 市場趨勢與產品策略
- 全球 AI IN ACTION 商務拓展
- ESG 永續承諾
- 財務資訊
- 提問與說明

innodisk

公司簡介與概況

公司概況



營業額

NT$ 615.14億元

(~2026 Q3)

資本額

NT$9.83億

EPS

NT$256.23

(~2026 Q3)

專利數

211

客戶數

4,000+

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

全球營運佈局

加州



紐澤西



荷蘭



北京



東京



波士頓

法國

德國

濟南 / 杭州 / 蘇州 / 上海

韓國

成都

廣州

越南

臺灣

德州



深圳



全球營運總部

/ 研發製造中心 / 韌體研發中心





營業地區

25

全球員工

1,259 台灣：1,111 / 海外：148

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

基地面積
（平方米）
27,000

建築面積：一廠
（平方米）
12,000

建築面積：二廠
（平方米）
15,000

Edge AI 系統與解決方案
Edge AI 嵌入式周邊模組
Edge AI 嵌入式相機模組

2026 產能
(SMT x 6)
1,080K

最大產能
(SMT x 8)
1,440K



宜蘭科學園區
研發製造中心



汐止
全球營運總部

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

廠辦空間

合計 5,900 坪

17F 500 坪 / 安提

16F 1,000 坪 / 研發中心、運動活動中心、訓練教室








7F 1,000 坪 / 安提 200 坪

5F 1,000 坪

4F 1,000 坪

3F 1,000 坪

2F 400 坪 / 安提 200 坪





產能	1,440K / 最大產能 (SMT x 8)
認證	ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / QC080000 / ISO14064-1 / ISO27001 / IEC62443-4-1
廠區	新北市 / 宜蘭縣



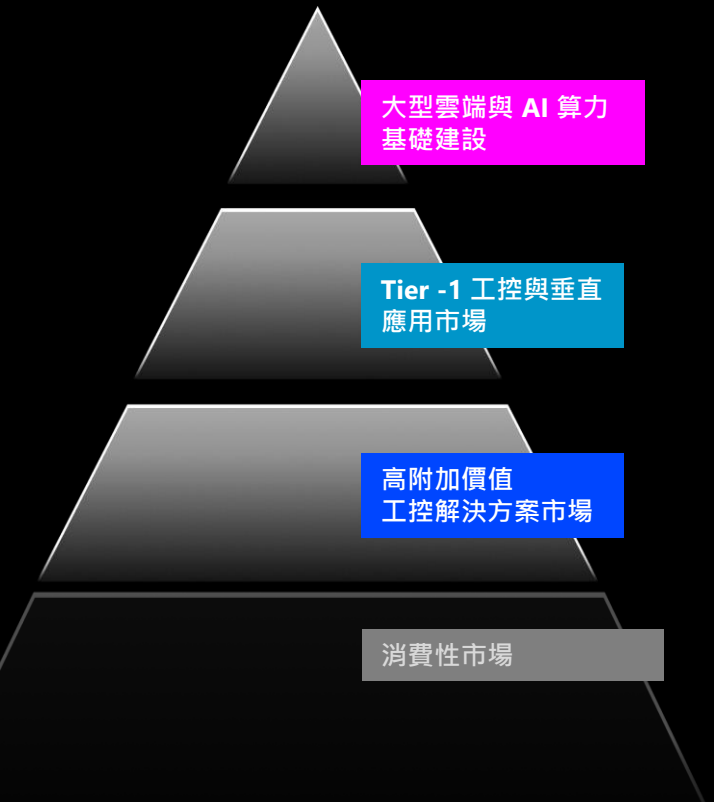
核心生產製造理念：品質、永續

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

市場趨勢與產品策略

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

全面推進高價值 AI 應用市場



全球領先記憶體與儲存供應商

- HBM, DRAM, NAND Flash

宜鼎的策略目標市場

高價值 AI 與工控應用

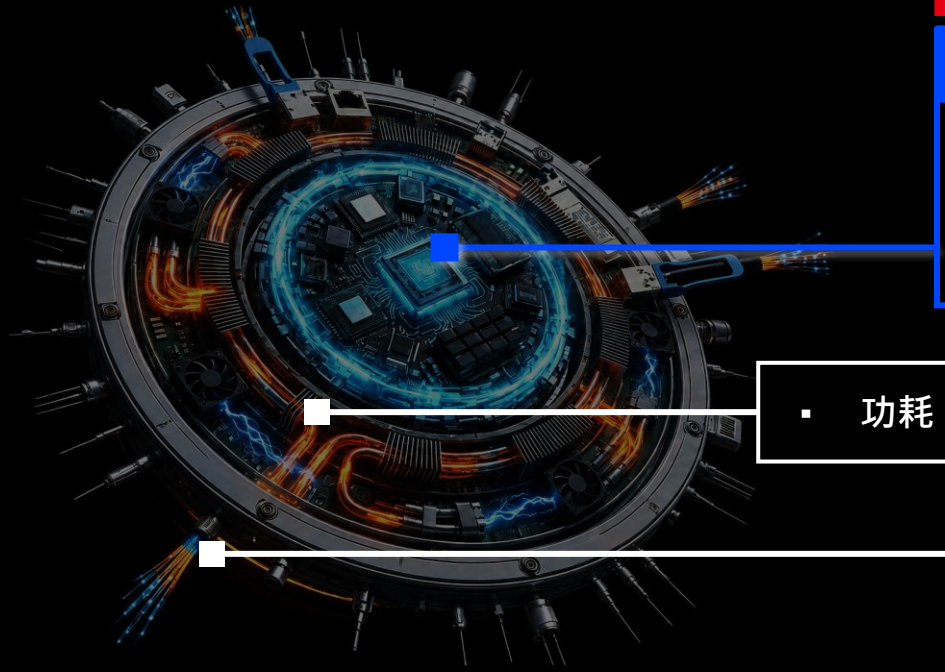
- 記憶體模組: DDR5, DDR4, CXL
- SSDs: Enterprise Boot Drive, Local Storage
- 邊緣 AI 系統 & 邊緣 AI 伺服器

共同推動全球
AI 基礎建設與應用

其他供應商的主要經營範疇

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

深化 AI 市場布局，擴大產業影響力



innodisk

宜鼎集團全面布局 AI 核心架構

- **運　算**：CPU / GPU / NPU / AI ASIC
- **記憶體**：記憶體模組 (DRAM Module)
- **儲　存**：嵌入式儲存 (Flash Storage)

- **功耗**：熱能源管理

- **傳輸**：光通訊

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

以堅強實力為後盾，驅動事業持續成長

扎實產品技術基礎

- 高階記憶體與儲存解決方案
- 邊緣 AI 系統/應用 整合落地實力
- 深度工控市場經驗

擴大應用市場滲透率

- 資料中心
- 智慧網卡 & 網路通訊
- 人形機器人 & 機器人應用
- 企業級 AI

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

以品質與研發實力，奠定高附加價值 AI 成長基礎



Tier-1
頂尖供應鏈



國際原廠
技術支援



100% Good Die
高品質原物料



工控等級
高穩定性



>50%
邊緣 AI 研發團隊



20+年
工控領域深耕基礎

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01
市場與應用產生的價值

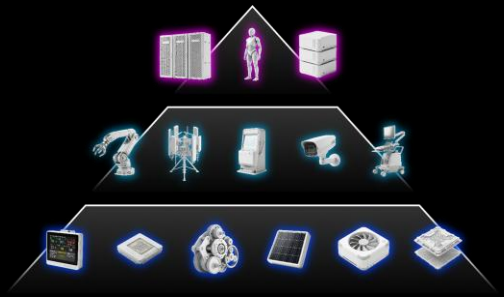
AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界、創造前所未有的產業價值躍升。

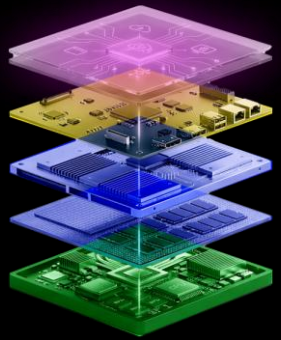
02
產品技術與人才的價值

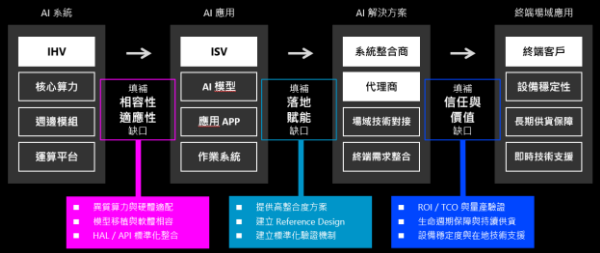
專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求。

03
Edge AI 快速整合落地的價值

填補技術缺口，憑藉研發實力與全球夥伴關係，建構多元異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研發的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地。







© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01
市場與應用產生的價值

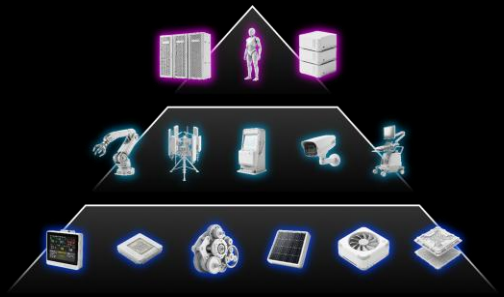
AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界、創造前所未有的產業價值躍升。

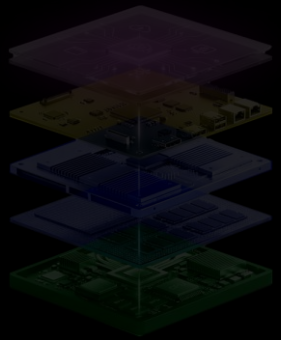
02
產品技術與人才的價值

專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求

03
Edge AI 快速整合落地的價值

憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研發的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地





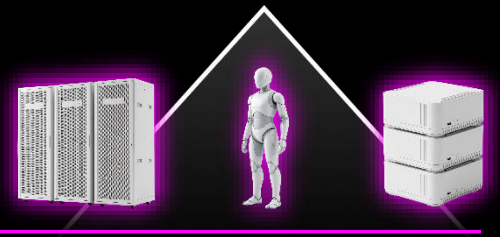


© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

01 市場與應用產生的價值

大型雲端
與 AI 算力基礎建設

- GPU 伺服器 / 網路交換器 / 路由器
- 人形機器人 / 無人自動化



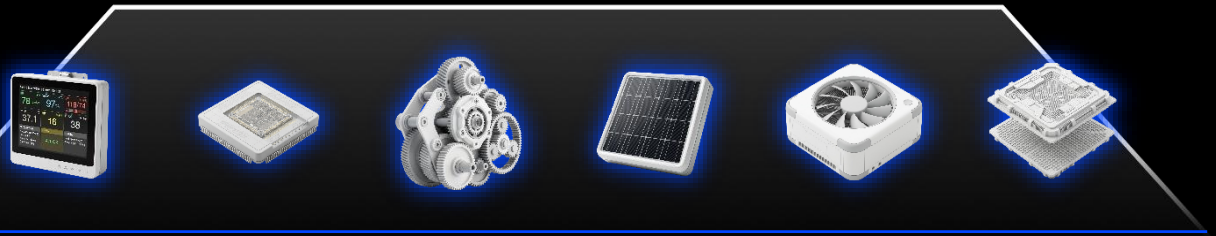
Tier -1 工控
與垂直應用市場

- 醫療保健 / 5G / 安防監控 / 媒體娛樂 / 自動化
- Tier-1 市場領導品牌



高附加價值
工控解決方案市場

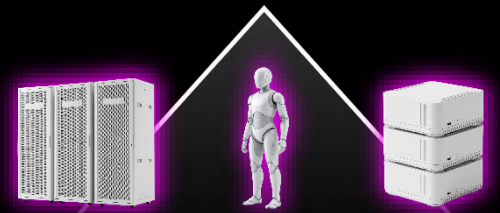
- 製造產業 / 零售物流 / 智慧能源 / 醫療保健 / 網路通訊 / 媒體娛樂 / 企業級應用



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

01 市場與應用產生的價值

大型雲端
與 AI 算力基礎建設



AI 基礎運算、資料與智慧儲存、高速傳輸與規模化部署的核心架構

CSP / 資料中心 / AI 加速運算

AI 訓練與推論規模持續擴張，推升高效能運算、高頻寬傳輸與大容量儲存需求，帶動相關產品技術呈現指數型成長

光通訊 / 網路通訊

AI 資料的傳輸流量高速成長，帶動低延遲、高頻寬與高可靠傳輸需求；藉由光通訊與網路通訊建設，將能支撐 AI 運算需求

機器人 / Physical AI

AI 技術發展，從網路世界走向實體場域，透過感知、運算與自主決策，推動機器人與物理 AI 融入人類決策與日常運作

企業型 AI

企業加速導入生成式 AI 與智慧應用，將資料轉化為營運洞察與商業成果，同時兼顧資料隱私、內部治理與營運效能優化需求

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

01 市場與應用產生的價值

Tier -1 工控與垂直應用市場



定義市場規格，引領產業應用創新、推動 AI 終端應用走向規模化部署

健康醫療

AI 加速診斷、治療與照護智慧化，提升醫療精準度與效率，推動先進醫療設備與服務規模化應用

網通與電信

AI 驅動網路即時分析、智慧調度與自動化維運，提升連線效能與服務品質，推動各式即時應用決策

安防監控

AI 視覺強化即時辨識、事件預警與決策，讓安防從被動影像紀錄，走向主動預防，提升公共場域安全性

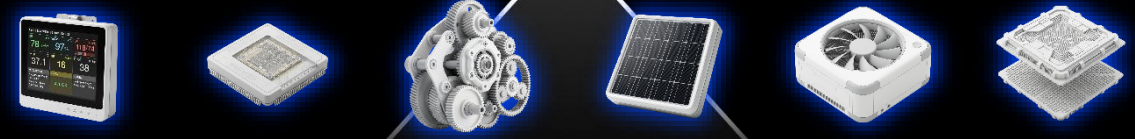
智慧製造

從自動化走向 AI 製造，不論 AI 影像辨識或機器人搬運與組裝，AI 正大規模提升整體生產製造效能

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

01 市場與應用產生的價值

高附加價值
工控解決方案市場



深耕多元工控場域，為全球 4,000+客戶提供客製整合服務，加速高附加價值 AI 應用落地

深度場域 Know-how

工控應用多元且環境複雜，設備、流程與場域條件大相逕庭，高度仰賴深度產業理解與應用經驗

高度客製整合

設備規格、介面與系統架構高度分散，軟硬體整合彈性與客製能力成為專案落地關鍵

高附加價值

產品差異化與智慧化需求持續提升，AI 與創新技術成為設備升級、強化終端應用競爭力的重要驅動力

長生命週期

工控設備具有長時間驗證測試與長使用週期特性，對產品可靠度、供貨穩定性具有高度要求

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01
市場與應用產生的價值

AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界、創造前所未有的產業價值躍升

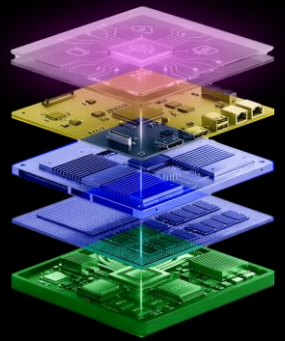
02
產品技術與人才的價值

專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求

03
Edge AI 快速整合落地的價值

憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研發的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地



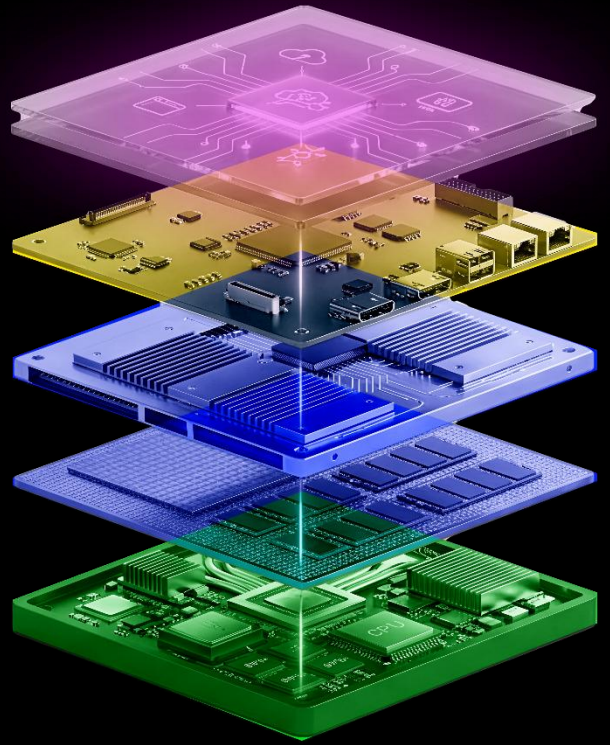




© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

- Stack 5: 軟體層 (Software)
- Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)
- Stack 3: 儲存層 (Storage)
- Stack 2: 記憶體層 (Memory)
- Stack 1: 算力層 (Compute)

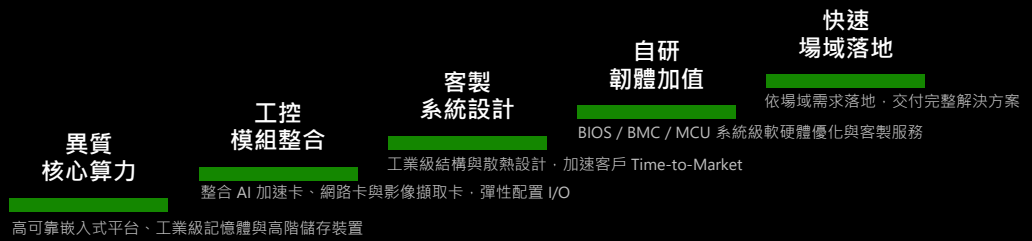


© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

- **Stack 5: 軟體層 (Software)**
- **Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)**
- **Stack 3: 儲存層 (Storage)**
- **Stack 2: 記憶體層 (Memory)**
- **Stack 1: 算力層 (Compute)**



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

- Stack 5: 軟體層 (Software)
- Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)
- Stack 3: 儲存層 (Storage)
- Stack 2: 記憶體層 (Memory)
- Stack 1: 算力層 (Compute)

韌性原廠供應鏈
多元IC供應鏈，嚴選原廠顆粒打造高品質

工控高規選料
智慧自動化生產，通過嚴苛環境品質驗證

領先市場研發上市
前瞻性產品研發與高階技術，領先業界推出

嚴苛驗證測試
嚴選工規關鍵零組件，打造最佳相容性

全球在地支援
全球在地化技術支援，提供長效生命週期保障

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

- **Stack 5: 軟體層 (Software)**
- **Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)**
- **Stack 3: 儲存層 (Storage)**
- **Stack 2: 記憶體層 (Memory)**
- **Stack 1: 算力層 (Compute)**

戰略
原廠生態伙伴
穩定且永續的供應鏈，原廠 Tier-1 核心料源

100%
自研開發
採用自主開發的高精度測試平台，落實檢驗品質

工控
研發團隊
20年產業經驗，專業研發工程師提供強大技術後盾

跨域
HW/FW整合
導入嚴謹的跨領域軟硬體 (HW/FW) 聯合驗證標準

全生命週期
保障
提供貫穿產品全生命週期的敏捷、客製化工程支援

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

- **Stack 5: 軟體層 (Software)**
- **Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)**
- **Stack 3: 儲存層 (Storage)**
- **Stack 2: 記憶體層 (Memory)**
- **Stack 1: 算力層 (Compute)**

跨平台設計
橫跨 x86、NVIDIA、Qualcomm 平台整合經驗

自研 Driver / FW
自主研發易於軟硬體整合導入的產品方案

高速傳輸智能連接
延伸至AI基礎設施的高速連接與資料傳輸市場

Sensor 感測客製
客製化研發及整合能力

多介面多外型
涵蓋LAN、Optical、Serial、CAN與EtherCAT，並可延伸PCIe、M.2等規格

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術

- **Stack 5: 軟體層 (Software)**
- **Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)**
- **Stack 3: 儲存層 (Storage)**
- **Stack 2: 記憶體層 (Memory)**
- **Stack 1: 算力層 (Compute)**

雲端設備管理
iCAP, OTA, OOB遠端管理

API / SDK 技術支援
API & SDK & Utility 開發與工具套件

BIOS / BSP / Driver 客製
底層驅動自研客製

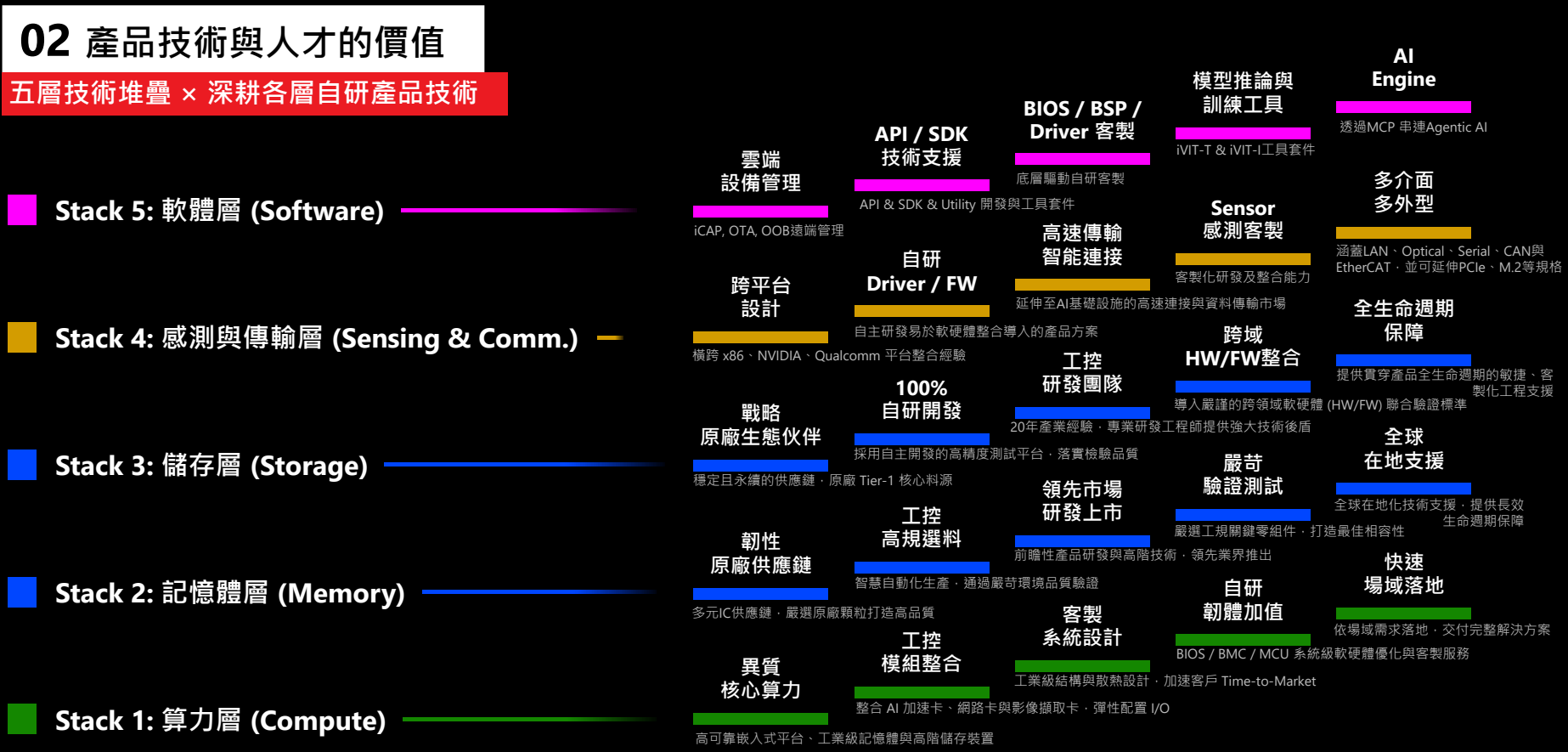
模型推論與訓練工具
iVIT-T & iVIT-I工具套件

AI Engine
透過MCP 串連Agentic AI

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

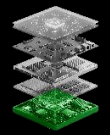
02 產品技術與人才的價值

五層技術堆疊 × 深耕各層自研產品技術



innodisk

Stack 1: 算力層 (Compute)



Powered by NVIDIA Qualcomm Intel


APEX-S100


APEX-X100


APEX-P100


AIB-AT78/68


APEX-X200


APEX-X100-Q


APEX-P300


AIE-PX11/12/21/22


APEX-P200


APEX-E300


APEX-A100


APEX-E100

10,000 TOPS

1,000 TOPS

100 TOPS

(TOPS @ INT8)

企業級 AI 運算

- 企業級 AI 平台
- AI 多代理協作
- RAG（檢索增強生成）
- Fine-Tuning（模型微調）
- 70B+ LLM 部署

進階 AI 推論

- 多相機 AOI
- 瑕疵分類與檢測
- 機器視覺
- 醫學影像
- 代理式 AI

邊緣視覺分析

- 監控影像分析
- 智慧零售
- 自動光學檢測（AOI）
- 人流分析
- 自主移動機器人（AMR）

基礎邊緣 AI 推論

- 影像分類
- 人臉辨識
- 光學字元辨識（OCR）
- 車牌辨識
- 單一物件偵測

innodisk

Stack 2 & 3: 記憶體與儲存層 (Memory & Storage)

產業型邊緣 AI

工控垂直應用市場

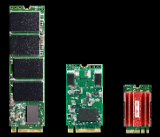
企業型邊緣 AI

企業私有 AI 伺服器

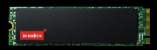
企業型邊緣 AI

AI 伺服器 / 雲端服務應用

On-device SSD



On-prem Edge AI /
KV Cache SSD



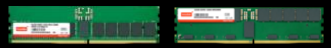
Central Cloud
Data Center SSD



DDR5 ECC SODIMM /
DDR5 ECC UDIMM / DDR5 RDIMM



DDR5 RDIMM /
DDR5 MRDIMM



CXL Memory Module /
CXL AIC / DDR5 MRDIMM

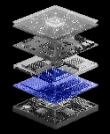


AI Inference

AI Training

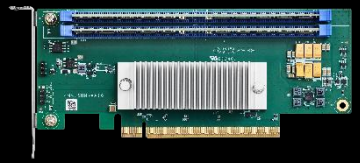
innodisk

Stack 2: 記憶體層 (Memory)



BREAKING AI ARCHITECTURE BOTTLENECKS

CXL AIC (ADD-IN-CARD) 打破 AI 記憶體牆瓶頸



- **目標市場**：為 AI 次世代極大化記憶體容量
- **關鍵特點**：無縫、大規模記憶體擴充
- **技術優勢**：優化超大規模資料中心和 AI 訓練的整體擁有成本

EMPOWERING EDGE AI COMPUTING

DDR5 8000MT/s RDIMM 邊緣 AI 超高速運算引擎



- **目標市場**：邊緣 AI 和高速網通頻寬需求
- **效能展現**：超低延遲和卓越的穩定性
- **應用領域**：即時邊緣推理和海量資料處理

DRAM Module Portfolio

AI Memory



Embedded Memory



Server Memory



Wide Temp. Memory

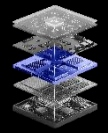


Customized Memory



- **規格尺寸**：
  CAMM2 / CUDIMM / CSODIMM / SODIMM / RDIMM / VLP / .....
- **技術與世代**：
  CXL / DDR5 / DDR4 / DDR3 / DDR2

innodisk



Stack 3: 儲存層 (Storage)

PCIe Gen5 & 218-layer 3D NAND Flash

MAXIMIZING SYSTEM BOOT RELIABILITY

資料中心 SSD | 開機碟

PCIe Gen5, 5TS4-P Series: E1.S and U.2



- **優化啟動**：高速啟動和高速作業系統載入
- **可靠性**：高耐久性，可承受頻繁的資料寫入

ACCELERATING LARGE-SCALE DATA THROUGHPUT

資料中心 SSD | 資料碟

PCIe Gen5, 5TS-P Serries: U.2, EDSFF (E3.S, E3.L and E1.S)



- **高吞吐量**：專為大規模資料處理設計，展現高效能與穩定性
- **低延遲**：高擴展性，滿足繁重的資料處理和儲存需求

Flash Storage (SSD) Portfolio

PCIe



SD



SATA



USB



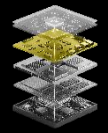
PATA



- **規格尺寸與技術：**
  M.2 / U.2 / CFexpress / EDSFF / 2.5" / 1.8" / SATA Slim / SATADOM / mSATA / CFast / nanoSSD /CompactFlash Card / SD Card & MicroSD Card / USB / USB EDC

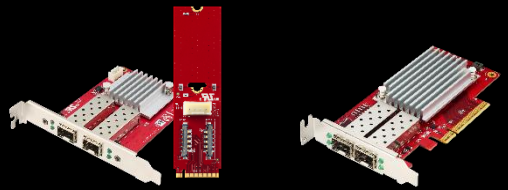
innodisk

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)



REVOLUTIONIZING COMPACT SYSTEM BOOTING

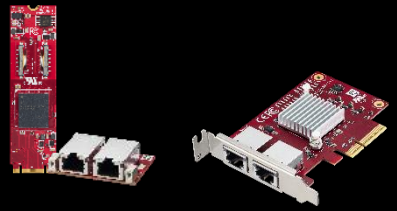
10GbE / 25GbE 光纖網路擴充卡



- **節省空間**：全球首款適用於小型機殼的 M.2 SFP+ 網路模組
- **高速傳輸**：高速穩定的資料傳輸，提升資料交換效率

ENHANCING HIGH-EFFICIENCY DATA EXCHANGE

10GbE RJ45 LAN 網路擴充卡



- **支援寬溫**：全球首款寬溫 10GbE 網路模組
- **優化啟動**：即時資料傳輸，滿足高效能應用

Intelligent Peripheral Solution Portfolio

LAN



CAN Bus & CAN FD



Serial

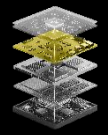


Wi-Fi



innodisk

Stack 4: 感測與傳輸層 (Sensing & Comm.)



RUGGEDIZED LONG-RANGE VISION & CLARITY

GMSL2 相機模組系列

高頻寬、長距離、低延遲

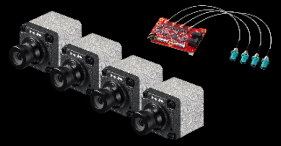


- **IP67/IP69K 防護等級**：達到最高防水防塵標準
- **15 公尺超長傳輸距離**：長距離傳輸依然穩定可靠
- **內建 ISP**：卓越畫質，專業影像控制
- **支援 NVIDIA Jetson 和 Raspberry Pi**：相容主流 AI 運算平台

REDEFINING THE EDGE AI VISION STANDARD

Innodisk 影像解決方案：Bundle Package

無縫整合、快速部署、效能實證



- **整合硬體套件**：GMSL2 攝影機與擷取卡完美搭配，方便快速驗證評估
- **無縫整合**：預先驗證的設計，消除相容性問題
- **加速開發**：專注於視覺軟體開發，快速完成部署
- **卓越效能**：提供清晰畫質與穩定的 GMSL2 訊號品質

Camera Module Portfolio

USB 2.0



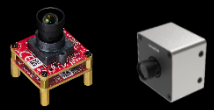
MIPI CSI-2



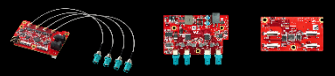
GMSL2



MIPI over Type-C



Capture Card



innodisk

Stack 5: 軟體層 (Software)

堅強軟體研發實力，創造邊緣 AI 附加價值

Retail Intelligence | Surveillance Intelligence | Enterprise & Building Intelligence | Industrial Automation Intelligence

商務邏輯層: iCAP | iVIT | innoPPE | AccelBrain

服務通訊層: HTTP | MQTT | CoAP | MCP

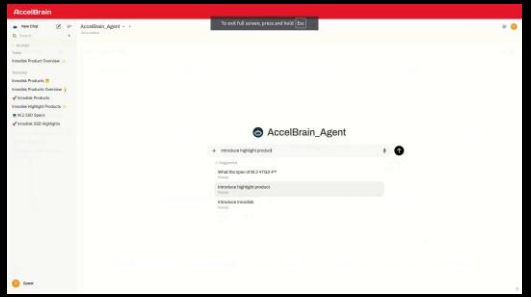
Host

服務 API 端點層: Device Management | AI Engine | Multi-Streaming

代理式AI層: MCP Server

平台賦能層: OS Building | BSP | Driver

硬體模組轉接層: eAPI | CANBus Utility | SSD SMART Utility | SPD Code R/W





© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎集團 市場與產品技術佈局 三大核心價值

01
市場與應用產生的價值

AI 加速新一波全球產業變革，重新定義產品、服務與營運的價值創造模式，將產業推向代理式與自主化，全面拓展應用邊界、創造前所未有的產業價值躍升

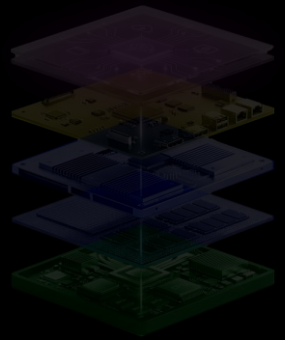
02
產品技術與人才的價值

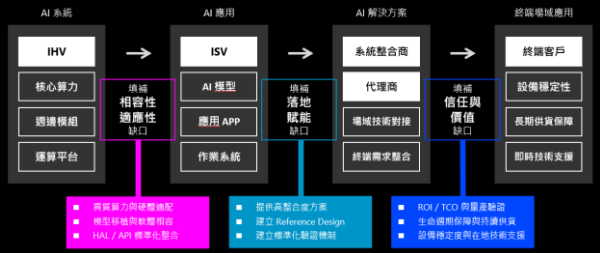
專注產品技術與人才發展，宜鼎建構完善的五層 AI 產品技術架構，並在專業人才的實踐下，打造高度相容且協同運作的 AI 解決方案，滿足全球客戶多元的應用需求

03
Edge AI 快速整合落地的價值

憑藉堅強的技術研發實力與全球夥伴關係，宜鼎建構多元的異質核心算力平台及週邊基礎，並結合自主研發的韌體與中介軟體，串聯終端應用，加速邊緣 AI 快速落地



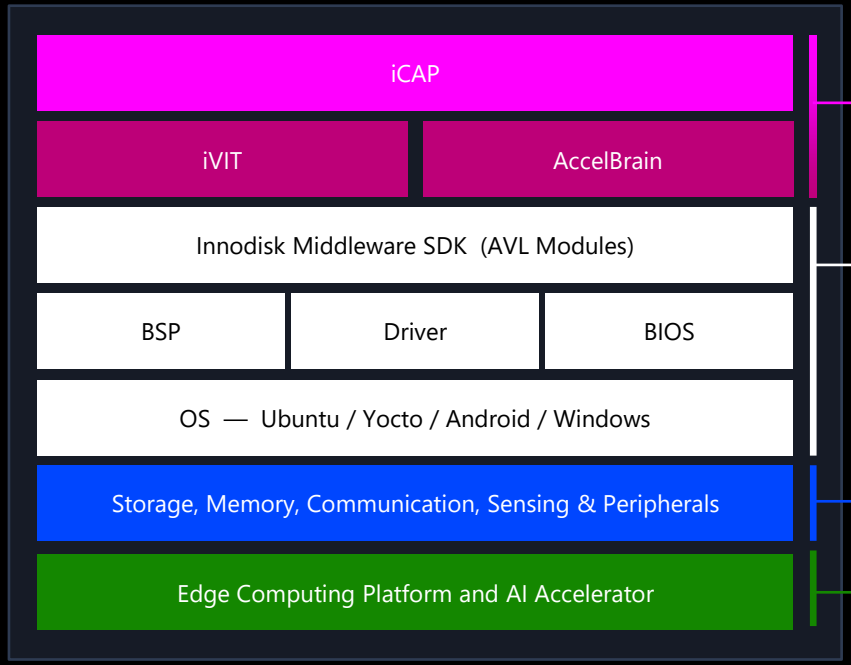




© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

03 Edge AI 快速整合落地的價值

從核心運算到 AI 應用，打造驗證測試與落地部署整合架構



跨層軟體架構

自主研發跨層架構，整合 OS、BSP、Driver、BIOS、Middleware、Utility 至上層 AI 模型與軟體應用，實現免移植、高整合、快速部署

原廠晶片支援與完整產品組合

與全球一線儲存與記憶體原廠合作，提供從資料感測、儲存、運算、傳輸到應用的完整產品線

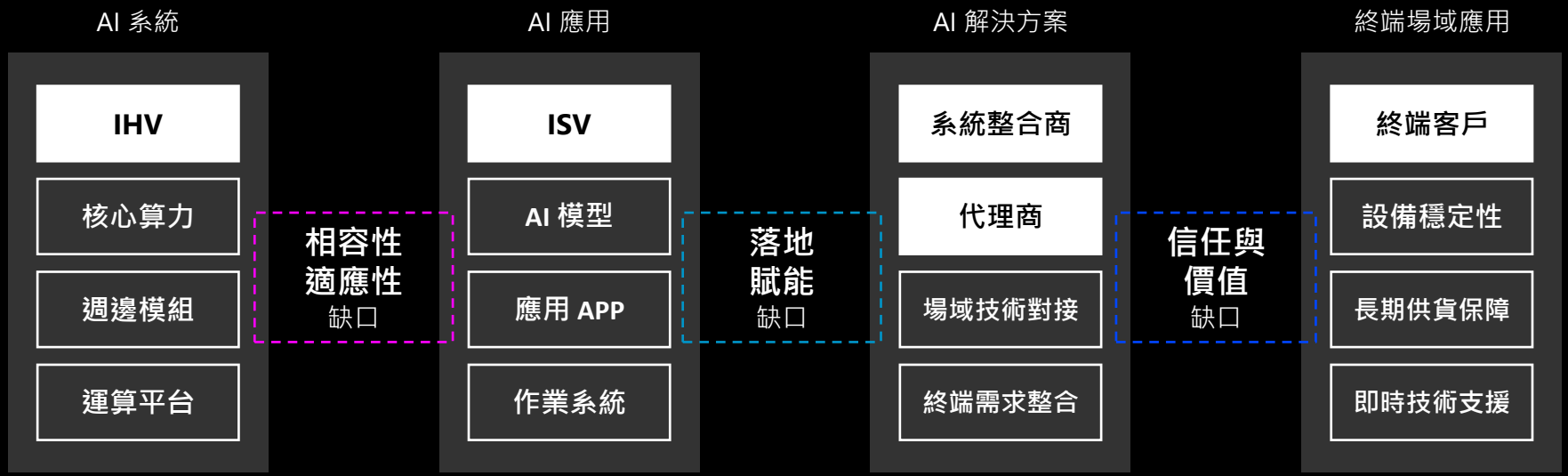
世界級設計與製造能力

- Intel：Reference Kit / Customer Reference Design
- NVIDIA：Elite Partner / MGX Partner (Aetina)
- Qualcomm：IoT 合作夥伴 / On-premise 合作夥伙
- 全球 AI ASIC：設計與製造服務

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

03 Edge AI 快速整合落地的價值

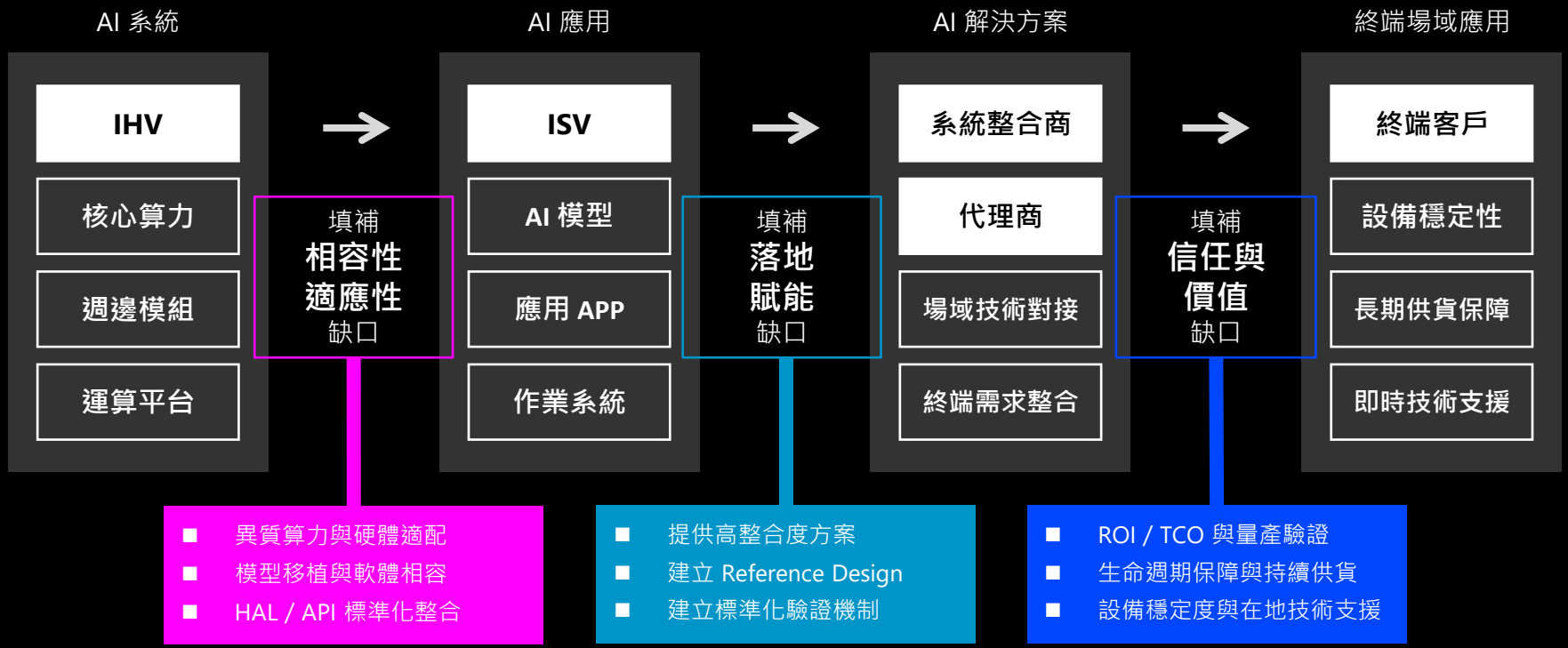
模組化填補技術缺口，分擔客戶端的試錯與技術整合工作



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

03 Edge AI 快速整合落地的價值

模組化填補技術缺口，分擔客戶端的試錯與技術整合工作



INNODISK 邊緣 AI 解決方案架構

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION



軟體 / 韌體

- 雲端 AI 平台: iCAP
- AI-Stack SDK: AccelBrain, AccelTune, IQ Studio, iVIT
- 軟體工具: iSeries Software
- OS & 中介軟體: Windows, Linux, BSP, eAPI, Drivers

AI 加速運算

- NVIDIA
- Intel
- Qualcomm
- AI ASIC

AI 平台

- x86
  - Intel Atom x6000 / 7000
  - Intel 12 / 13 / 14th Gen Core-i
  - Intel Core Ultra Series1 / 2 / 3
  - Intel Xeon 6
- ARM
  - NVIDIA Jetson Orin / Thor
  - Qualcomm Dragonwing IQ 9 / 8 / X
  - NXP i.MX 8M Plus / 95

AI 儲存 / 記憶體

- Flash
- DRAM

AI 周邊模組

- Camera
- LAN
- Display
- Air Sensor / Gas Sensor
- Wireless
- Storage
- CAN Bus / CAN FD
- Serial

裝置管理

監測 / OTA / 診斷

推論 & 調教

模型部署 / 訓練 / 優化

執行 & 系統支援

OS 移植 /
執行環境支援 /
預先配置系統 /
eAPI 硬體控制 /
軟體設定

資料管理

韌體客製化 /
健康狀態監控 /
加密 & RAID

感測 & 傳輸

視覺輸入 /
資料傳輸 /
即時控制

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

市場與應用產生的價值

大型雲端
與 AI 算力基礎建設

- GPU 伺服器 / 網路交換器 / 路由器
- 人形機器人 / 無人自動化



市場指數成長

Tier -1 工控
與垂直應用市場

- 醫療保健 / 5G / 安防監控 / 媒體娛樂 / 自動化
- Tier-1 市場領導品牌



全球應用市場標竿

高附加價值
工控解決方案市場

- 製造產業 / 零售物流 / 智慧能源 / 醫療保健 / 網路通訊 / 媒體娛樂 / 企業級應用



4,000+高附加價值客戶群


三期
預計 2026 年底動工
二期
2024 (啟用)
一期
2018 (啟用)
innodisk
innodisk
innodisk
宜鼎國際研發製造中心
三期廠房暨宿舍興建工程


宜鼎國際研發製造中心
三期廠房暨宿舍興建工程
預計 2026 年底動工
三期
二期
一期
innodisk


三期
二期
一期
宿舍


三期
宿舍
一期



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

全球 AI IN ACTION 商務拓展

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

COMPUTEX 台北國際電腦展 2026

@台灣 台北















© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

INNODISK AI IN ACTION

全球邊緣 AI 解決方案拓展



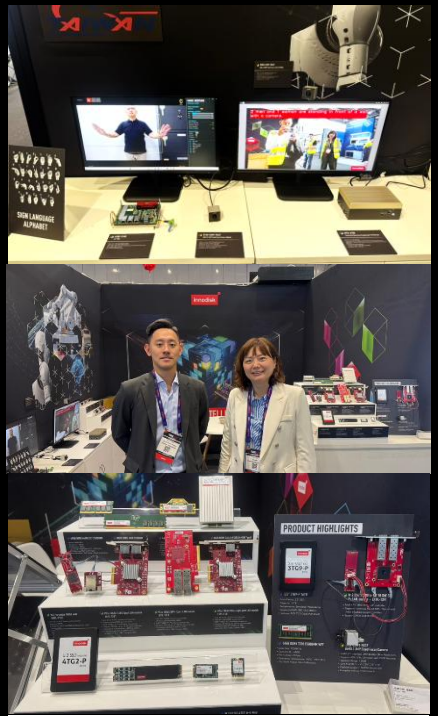
AI EXPO @Taiwan



IT Week @Japan



Automate @USA



Hardware Pioneer Max @United Kindom

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

ESG 永續承諾

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

宜鼎永續 亮點成果

- 公司治理評鑑名列 **6～20%** 等級
- 通過董事會核准淨零排放路徑目標，積極邁向淨零轉型的長程方向
- 成立**「永續發展暨資安委員會」**，強化公司在環境、社會、治理與資訊安全面向的整合管理與效率
- 榮獲國際 EcoVadis 銅級及天下永續公民獎、天下人才永續獎、親子天下友善家庭職場獎等多項殊榮，展現宜鼎在永續治理的全方位成果

生態共好 亮點專案

無尾港水鳥保護區：生物多樣性 三年計畫

- 攜手在地團體，投入棲地守護、外來種清除與小燕鷗復育，以實際行動守護生物多樣性環境。
- 透過生態監測與環境教育，結合利害關係人共同構築生物多樣性共榮圈。

岳明國中小：蔚藍行動家培育 三年計畫

- 串聯學界與社區力量，培育未來蔚藍行動家，擴大在地永續發展之社會效益。
- 深入校園推動生態保育教育，透過工作坊、創新提案等，扎根永續素養。







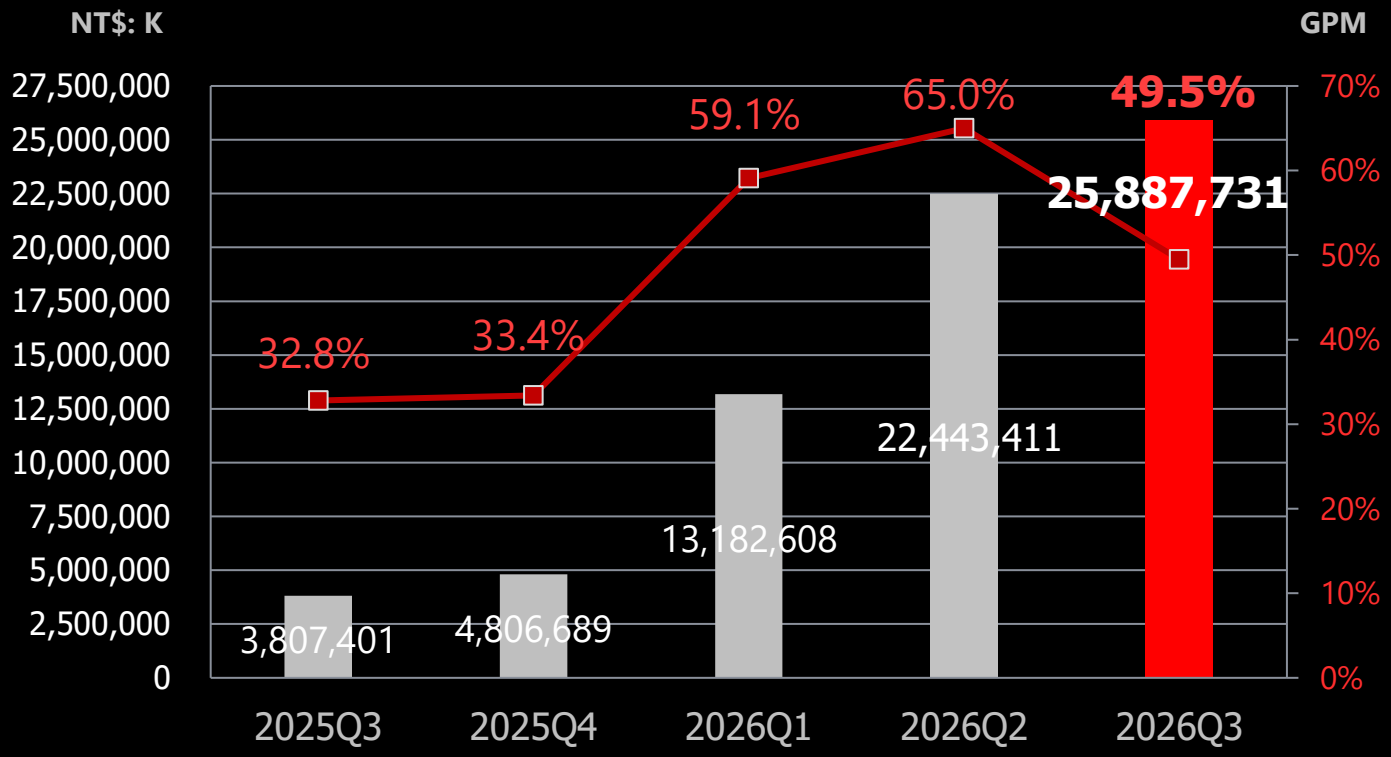
宜鼎國際 永續之路

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

財務資訊

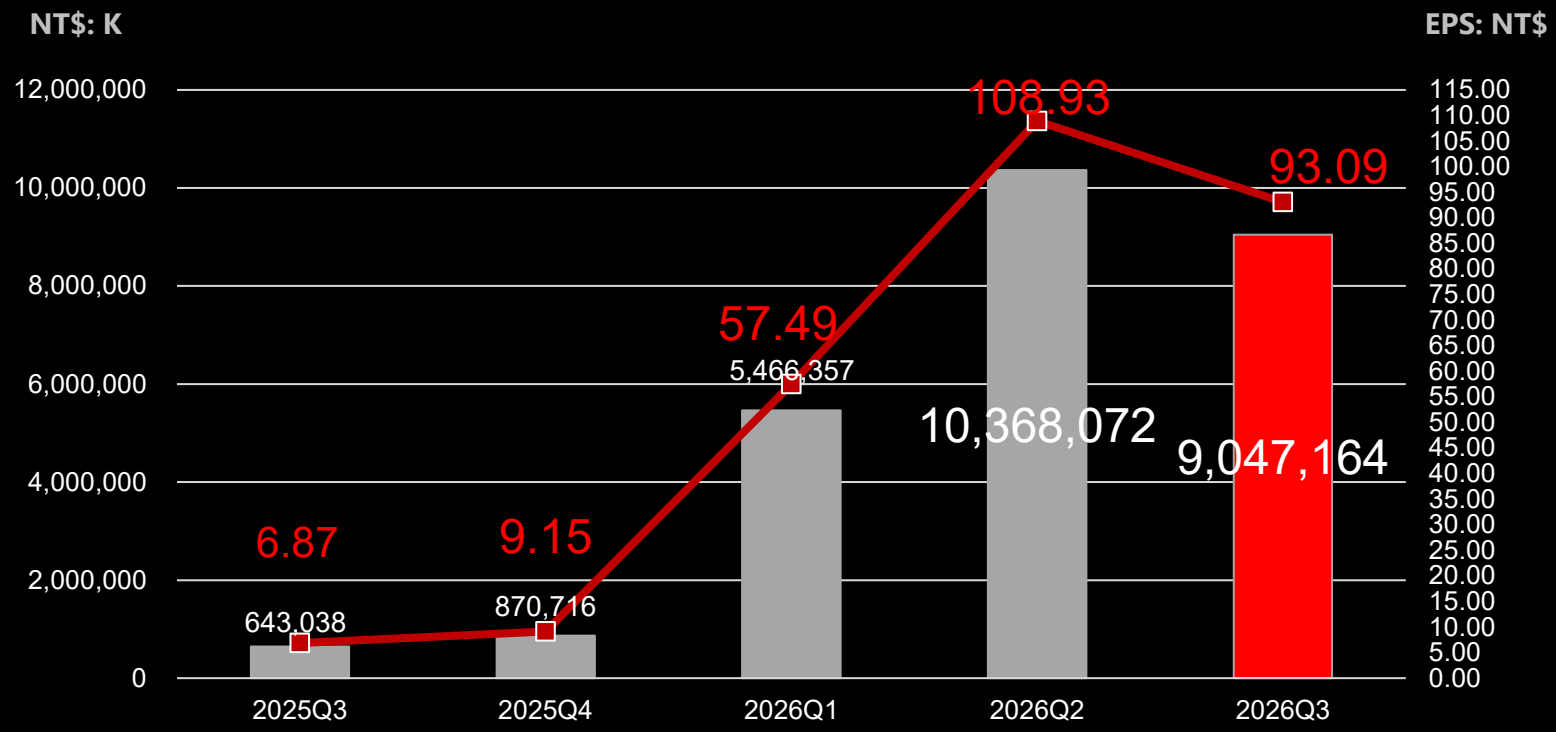
© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

過去5季營收與毛利率



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

過去5季淨利與EPS

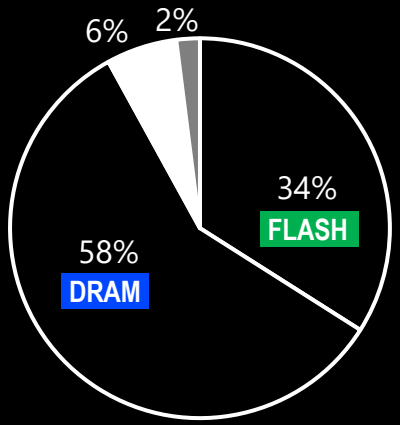


附註:季度EPS依據當季股本計算

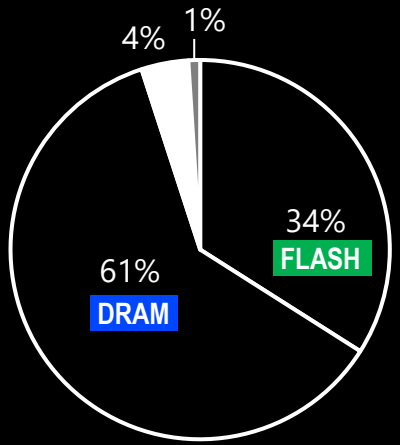
© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

產品營收佔比變化

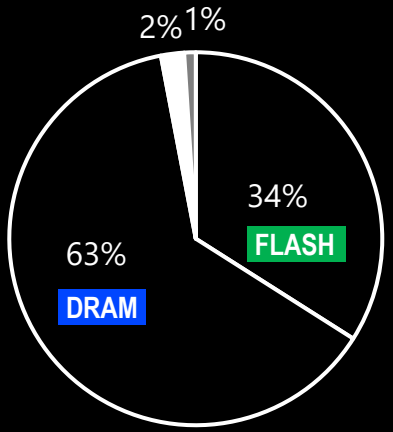
2025Q3



2026Q2



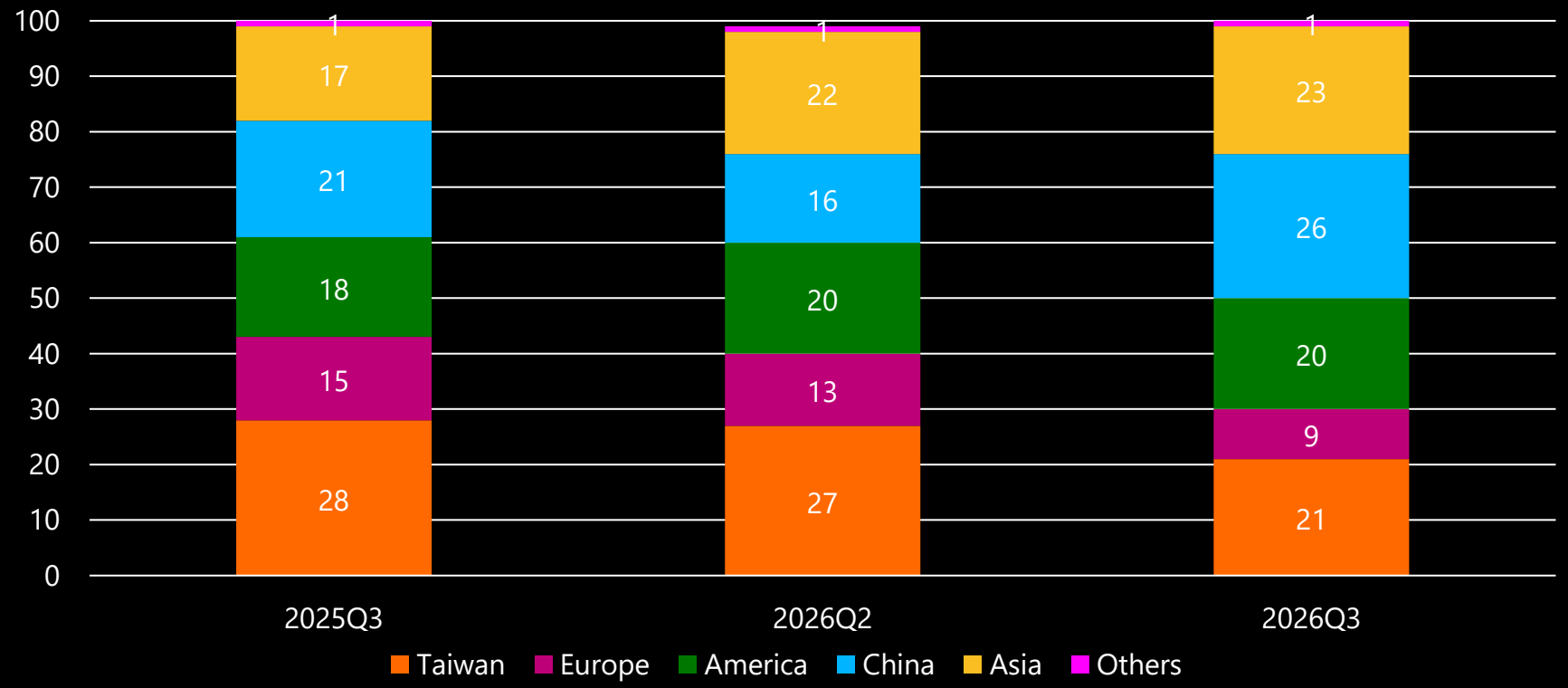
2026Q3



DRAM FLASH AI Solutions Others

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

營收依區域佔比



© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

2026Q3 營運成果

	2026Q3	2026Q2	QoQ	2025Q3	YoY
營業收入	**25,887,731**	**22,443,411**	**15.3%**	**3,807,401**	**579.9%**
營業成本	13,080,680	7,853,799	66.6%	2,558,583	411.2%
營業毛利	**12,807,051**	**14,589,612**	**-12.2%**	**1,248,818**	**925.5%**
營業費用	1,452,136	1,443,892	0.6%	531,059	173.4%
營業利益	**11,354,915**	**13,145,720**	**-13.6%**	**717,759**	**1482.0%**
營業外收入及支出	100,706	68,664	46.7%	88,738	13.5%
稅前淨利	**11,455,621**	**13,214,384**	**-13.3%**	**806,497**	**1320.4%**
所得稅費用	2,390,827	2,808,521	-14.9%	163,923	1358.5%
本期淨利	**9,064,794**	**10,405,863**	**-12.9%**	**642,574**	**1310.7%**
非控制權益利益	17,630	37,791	-53.3%	-464	-3899.6%
歸屬母公司淨利	**9,047,164**	**10,368,072**	**-12.7%**	**643,038**	**1306.9%**
基本每股盈餘	93.09	108.93		6.87	
毛利率	49.5%	65.0%		32.8%	
營業利益率	43.9%	58.6%		18.9%	
淨利率	35.0%	46.4%		16.9%	

附註:季度EPS依據當季股本計算

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

提問與說明

© COPYRIGHT INNODISK CORPORATION

innodisk

ARCHITECT INTELLIGENCE